

PRESSEINFORMATION

adSphere GmbH
Zur Wetterwarte 27
01109 Dresden
Fon: +49 351 79 59 79 7-60
info@adSphere.solutions

DATUM: 13. März 2019

KONTAKT: Herr Uwe Beier, uwe.beier@adSphere.de

LOPEC: adSphere präsentiert gedruckte, flexible Elektronik in 3D-Form auf der internationalen Fachmesse für flexible Elektronik in München

Flexible gedruckte Elektronik in 3D-Form

Durch den Einsatz innovativer Technologien ist es gelungen zweidimensional bedruckte und bestückte Elektronik mittels Thermoformen in die 3D-Form zu überführen. Durch die gezielte Steuerung des Umformprozesses kann die Dehnung deutlich homogenisiert und selektiv eingestellt werden, sodass höhere Umformgrade erreicht werden können und die empfindliche Elektronik geschützt wird.

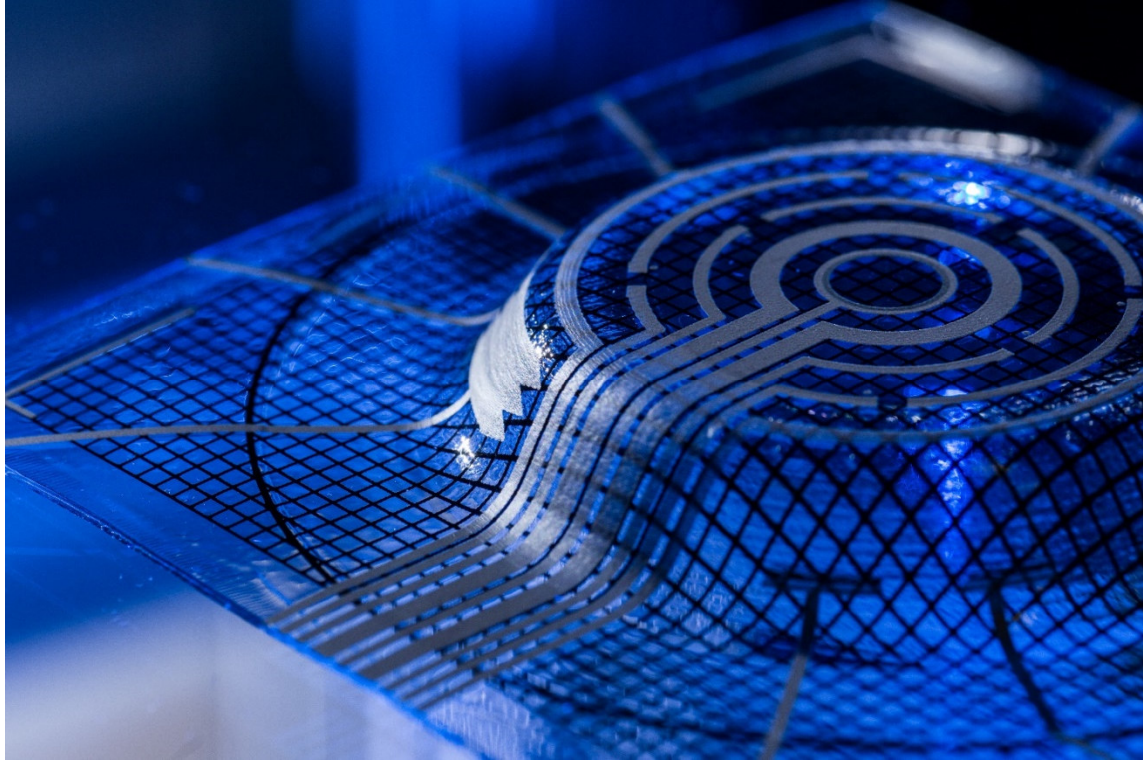
Zur Demonstration der Technologien und Darstellung der neuen Produkt- und Designmöglichkeiten realisiert adSphere eine Demonstratoranlage, mit der diese Technologien in das Rolle-zu-Rolle-Verfahren implementiert werden. So wird die Herstellung von 3D-Elektroniken im massentauglichen kostengünstigen Verfahren ermöglicht.

Die Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette: Material – Druckprozess – Bestückung – Umformprozess - R2R-Handling – Produkt sind derartig komplex, dass diese vorteilhafter Weise in engverzahnten Kooperationen umgesetzt werden: „Glücklicherweise sind in unserem Netzwerk alle notwendigen Technologien vorhanden“ erklärt Beier überzeugend – „und mit dem Organic Electronic Saxony (OES) haben wir einen international erfahrenen Netzwerkpartner, der bei der Anbahnung von Geschäftsverbindungen kompetente Unterstützung liefert“.

Durch die neue Technologie können Eingabegeräte neu definiert werden: sie sind spaltfrei, hygienisch und wasserdicht und somit für Anwendungen in der Medizintechnik oder der Automobilindustrie bestens geeignet.

Im Rahmen der LOPEC - Internationale Fachmesse für flexible Elektronik – präsentieren adSphere und das Fraunhofer IVV am 20. und 21. März 2019 in München **am Stand B0-407 erste Funktionsmuster, welche auf von der Rolle bedruckt und anschließend in eine 3D-Form überführt wurden.**

Ihr Experte bei adSphere:
Uwe Beier, Geschäftsführer
Tel: +49 351 79 59 79 7-60
uwe.beier@adSphere.de
www.adSphere.solutions



Technologiepartner:

Adenso

R2R-Handling-Technologie

www.R2R.solutions

www.UTG.solutions

adSphere

Sensor.Solutions

adSphere.controller

www.adSphere.solutions

 **Fraunhofer**
IZM

Kontakttechnologien

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration
IZM

www.izm.fraunhofer.de

 **Fraunhofer**
IVV

Umformtechnologien

Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV

www.ivv.fraunhofer.de

 **TES frontdesign**
Wir bringen Intelligenz in Form

Eingabe- und Bediensysteme

TES Frontdesign

Siebdruck und Bestückung mit SMD-Bauelementen

www.tes-frontdesign.de

ACCOMPLAST GmbH

Spritzguss und Oberflächenveredelung

ACCOMPLAST

<http://www.accomplast.de>

OES
Organic Electronics Saxony

Cluster-Kompetenz

OES Organic Electronics Saxony

www.oes-net.de